環境負荷化学物質含有量

環No.2014-43
2014年10月22日

株式会社ステップテクニカ　管理部
TEL 04-2964-8804 FAX 04-2964-7653
E-mail info@steptechnica.com

製品名 ： MKY43
部品質量(mg)： 260

部位	素材・化学物質	CAS No.	質量 (mg)	部位含有率 (wt%)	全体含有率 (wt%)	使用目的
チップ	シリコン(Si)	7440-21-3	11.968	99.4587	4.6031	素子材料
	ヒ素(As)	7440-38-2	1.00E-04	0.0005	0.00E+00	ドーパント
	ホウ素(B)	7440-42-8	4.00E-04	0.0032	2.00E-04	ドーパント
	リン(P)	7723-14-0	1.50E-03	0.0125	6.00E-04	ドーパント
	チタン(Ti)	7440-32-6	2.21E-02	0.1835	8.50E-03	回路形成
	タングステン(W)	7440-33-7	5.40E-03	0.0445	2.10E-03	回路形成
	銅(Cu)	7440-50-8	1.00E-04	0.0009	0.00E+00	回路形成
	アルミニウム(Al)	7429-90-5	3.56E-02	0.2962	1.37E-02	回路形成
チップマウント	銀(Ag)	7440-22-4	0.9973	79.9998	0.3836	導電性材料
	エポキシ樹脂(EP)	---	0.2493	20.0002	0.0959	接合材料
リードフレーム	銅(Cu)	7440-50-8	109.0576	96.5646	41.9452	フレーム材料
	鉄(Fe)	7439-89-6	2.5674	2.2733	0.9875	フレーム材料
	銀(Ag)	7440-22-4	1.3125	1.1621	0.5048	銀メッキ
ワイヤ	金(Au)	7440-57-5	1.2823	100	0.4932	配線
外部端子メッキ	スズ(Sn)	7440-31-5	8.7338	100	3.3591	端子表面処理材料
パッケージ	エポキシ樹脂(EP)	---	16.956	13.7	6.5215	封止樹脂材料
	有機リン化合物	---	1.2377	1	0.476	封止樹脂硬化剤
	シリカ(SiO2)	60676-86-0	105.2016	85	40.4622	封止樹脂材料
	カーボン(C)	1333-86-4	0.3713	0.3	0.1428	封止樹脂材料
		含有量合計	260		100	